

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不擬作為亦不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦不會成為有關邀請或要約的一部分。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站就本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市刊發的《華虹半導體有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告》，僅供參閱。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零二三年七月三十一日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

張素心（董事長）

唐均君（總裁）

非執行董事：

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壩，太平紳士

葉龍蜚

华虹半导体有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

华虹半导体有限公司（以下简称“发行人”或“华虹公司”）首次公开发行40,775.0000万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1228号文同意注册。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（国泰君安及海通证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或合称“联席主承销商”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或合称“联席主承销商”）、东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或合称“联席主承销商”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”或合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。

发行人的股票简称为“华虹公司”，扩位简称为“华虹半导体公司”，股票代

码为“688347”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 52.00 元/股，发行数量为 40,775.0000 万股，全部为公开发行新股，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 20,387.5000 万股，占发行总数量的 50.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 20,387.5000 万股，占本次发行总数量的 50.00%，因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同，本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。

网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后，网下发行数量为 16,310.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上发行数量为 4,077.5000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为 20,387.5000 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 2,126.47 倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 2,038.7500 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 14,271.2500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为 4,281.1752 万股，网下有锁定期部分最终发行数量为 9,990.0748 万股；网上最终发行数量为 6,116.2500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终

中签率为 0.07053958%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

1、联席保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）、海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）跟投；

2、其他参与战略配售的投资者：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业和国家级大型投资基金或其下属企业。

截至 2023 年 7 月 20 日（T-3 日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。联席主承销商已于 2023 年 7 月 31 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。本次发行战略配售的最终情况如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数 占本次初 始发行数 量的比例	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	48,334,249	11.85%	2,513,380,948.00	12
2	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司		23,076,923	5.66%	1,199,999,996.00	12
3	中国保险投资基金（有限合伙）		13,461,538	3.30%	699,999,976.00	12
4	中国互联网投资基金（有限合伙）		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
5	浙江制造基金合伙企业		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数 占本次初 始发行数 量的比例	获配金额 (元)	限售期 (月)
	(有限合伙)					
6	国新投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	23,076,923	5.66%	1,199,999,996.00	12
7	上海国际集团资产管理有限公司		9,615,384	2.36%	499,999,968.00	12
8	无锡市创新投资集团有限公司		7,692,307	1.89%	399,999,964.00	12
9	上海科技创业投资(集团)有限公司		4,807,692	1.18%	249,999,984.00	12
10	上海浦东科创集团有限公司		4,807,692	1.18%	249,999,984.00	12
11	建投投资有限责任公司		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
12	上海国盛(集团)有限公司		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
13	上海国投资本管理有限公司		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
14	无锡产业发展集团有限公司		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
15	成都高新投资集团有限公司		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
16	重庆渝富资本运营集团有限公司		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
17	阿布达比投资局		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
18	深圳安鹏创投基金企业(有限合伙)		2,115,384	0.52%	109,999,968.00	12
19	浙江金控投资有限公司		1,923,076	0.47%	99,999,952.00	12
20	上海汽车集团股份有限公司		1,923,076	0.47%	99,999,952.00	12
21	聚辰半导体股份有限公司		1,923,076	0.47%	99,999,952.00	12
22	上海澜起红利企业管理合伙企业(有限合伙)		1,923,076	0.47%	99,999,952.00	12
23	盛美半导体设备(上海)股份有限公司		1,923,076	0.47%	99,999,952.00	12
24	中微半导体设备(上海)股份有限公司		1,923,076	0.47%	99,999,952.00	12
25	上海张江科技创业投资有限公司		1,538,461	0.38%	79,999,972.00	12
26	上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合		961,538	0.24%	49,999,976.00	12

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数 占本次初 始发行数 量的比例	获配金额 (元)	限售期 (月)
	伙)					
27	安集微电子科技(上海)股份有限公司		961,538	0.24%	49,999,976.00	12
28	上海硅产业集团股份有限公司		961,538	0.24%	49,999,976.00	12
29	国泰君安证裕投资有限公司	保荐人相关 子公司	8,155,000	2.00%	424,060,000.00	24
30	海通创新证劵投资有限公司		8,155,000	2.00%	424,060,000.00	24
合计			203,875,000	50.00%	10,601,500,000.00	

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：59,817,889 股；
- 2、网上投资者缴款认购的金额：3,110,530,228.00 元；
- 3、网上投资者放弃认购数量：1,344,611 股；
- 4、网上投资者放弃认购金额：69,919,772.00 元。

(三) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：142,712,500 股；
- 2、网下投资者缴款认购的金额：7,421,050,000.00 元；
- 3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
- 4、网下投资者放弃认购金额：0 元。

二、联席主承销商包销情况

本次发行网上投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为 1,344,611 股，包销金额为 69,919,772.00 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为 0.66%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为 0.33%。

2023 年 7 月 31 日 (T+4 日)，联席主承销商将包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至

联席主承销商指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为 28,232.30 万元：

- 1、保荐承销费用：26,058.60 万元
- 2、审计、验资费用：822.65 万元
- 3、律师费用：636.00 万元
- 4、用于本次发行的信息披露费用：590.00 万元
- 5、发行手续费用及其他：125.05 万元

注：本次发行各项费用均为含增值税金额。与《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》里披露预计发行费用的差异系发行人印花税的调整。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

四、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-38676888

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：021-23187958

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

电话：010-60838692

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：010-65051986

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联系人：股权资本市场部

电话：021-23153864

联席主承销商：国开证券股份有限公司

联系人：资本市场组

电话：010-88300198

发行人：华虹半导体有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

2023年7月31日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）



发行人：华虹半导体有限公司

2023年7月31日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司



2023年7月31日

(此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2023年7月31日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2023年7月31日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023年7月31日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国开证券股份有限公司



2023年7月31日